

华天科技20亿元A股非公开发行股票



华天科技主要从事集成电路的封装测试业务，集成电路年封装能力和销售收入均位列我国同行业上市公司第二位，盈利能力位列同行业上市公司第一名

发行概要

发行总额	20亿人民币
认购对象及方式	本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，所有投资者以现金认购本次发行的股份
发行数量	本次非公开发行A股股票数量不超过17,256万股（含17,256万股）
发行价格	本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.65元/股。公司2014年度利润分配实施完成后，发行价格调整为不低于11.59元/股。最终发行价格为16.31元/股
限售期	本次发行完成后，所有发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让
募集资金用途	本次发行股票募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于集成电路高密度封装扩大规模项目、智能移动终端集成电路封装产业化项目、晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金
上市地点	深圳证券交易所

执行亮点

- 瑞信方正独家保荐及承销，出色执行能力保证项目快速推进
 - 自2015年2月3日发布非公开融资预案至2015年11月25日公告上市公告书，历时9个月（含监管暂停审核1个月）
- 精心设计募投项目，募资金额超发行人既往融资总和
 - 本次募集资金量超过公司上市以来三次融资之和（含IPO募资）
 - 募投项目设计合理，全部用于国家大力鼓励发展的集成电路行业，除补充流动资金之外，涵盖了半导体封装的高中低端生产线，既保证了企业短期产能的需求，也充分考虑了企业的未来发展空间
 - 募投项目主要投向西安和天水，两地均为丝绸之路经济带的重点城市，有力地支持了国家一路一带的战略

承销亮点

- 在动荡的市场环境下把握了优质的发行窗口
 - 2015年7月以来A股二级市场发生剧烈波动，上证综指不到4周时间下跌34.85%。发行人所属中小板块指数跌幅更是一度高达48.53%
 - 2015年10月以后市场刚刚企稳，又逢IPO即将重启，市场资金面压力巨大。瑞信方正帮助发行人推动加快内外部工作流程，及时抓住公司三季报报喜、市场投资者情绪恢复的双重有利时机，在取得发行批文后8个工作日内即完成发行，实现了良好的发行结果
- 大量有效的投资者沟通工作，获得了大型专业机构投资者的青睐
 - 为发行人成功举办北京、上海、西安三地一对一路演及团体路演沟通，覆盖各类投资者，充分演绎发行人投资故事，帮助市场挖掘投资价值
 - 积极开展投资者询价工作，稳妥锁定意向投资者，最终获得投资者认购意向函逾80份，发送认购邀请书的拟询价对象近160家
 - 最终配售对象既包括公募基金、资管等传统机构投资者，又包括社保基金、国有企业财务公司等战略投资者，投资者结构搭配合理
- 踊跃的认购情况，最终定价降低摊薄效应
 - 投资者踊跃认购，最终发行价格16.31元/股，较发行底价溢价40.72%，较T日当天收盘价仅折让10.92%，减少了对原股东的摊薄